

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门弘信电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法经本公司董事会第二届第五次会议审议通过，并业经公司 2016 年度股东大会表决通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2017 年 5 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 5 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 4 月 28 日签发的证监许可[2017]617 号文《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,600 万股，每股发行价格为人民币 7.77 元，股款以人民币缴足，计人民币 202,020,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费、中介机构服务费用、以及其他交易费用共计人民币 38,016,000.00 元后，净募集资金共计人民币 164,004,000.00 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2017）第 350ZA0024 号”验资报告。本公司募集资金于 2017 年 5 月 18 日到账后，经董事会批准全部用于置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目计 164,004,000.00 元。截至 2021 年 5 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

（三）非公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 2 日签发的证监许可[2019]1182 号文《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公

司非公开发行不超过 30,313,428.00 股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 30,313,428.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.83 元/股，股款以人民币缴足，计人民币 722,368,989.24 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费、中介机构服务费用以及其他交易费用共计人民币 17,197,662.68 元后，净募集资金共计人民币 705,171,326.56 元。上述募集资金于 2019 年 8 月 27 日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2019）第 350ZA0031 号”验资报告。

截至 2021 年 5 月 31 日，本公司前次非公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	2021 年 5 月 31 日余额
中国工商银行厦门翔安支行	15,761.75
兴业银行股份有限公司厦门分行	89,542.93
中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行	1,116,905.90
招商银行股份有限公司厦门翔安支行	669,332.31
中国进口银行厦门分行	71,061,235.44
合 计	72,952,778.33

上述存放余额不包括募集资金现金管理中持有未到期的通知存款户余额 50,304,880.98 元，结构性存款 30,000,000.00 元。

（四）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1955 号《关于同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，本公司向不特定对象发行面值总额为人民币 570,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共 5,700,000.00 张，按票面金额平价发行，债券期限为 6 年。扣除发行费用人民币 7,781,182.22 元（不含税）后，本次发行实际募集资金净额为人民币 562,218,817.78 元。该募集资金已于 2020 年 10 月 21 日全部到位。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0084 号”验资报告。

截至 2021 年 5 月 31 日，本公司前次公开发行可转换公司债券在银行账户的存

放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	2021 年 5 月 31 日余额
兴业银行股份有限公司厦门分行	101,614.71
平安银行厦门分行营业部	56,227,116.51
中国进口银行厦门分行	16,337,190.53
招商银行股份有限公司厦门翔安支行	700.57
合 计	72,666,622.32

上述存放余额不包括募集资金现金管理中持有未到期的通知存款户余额 1,092,234.14 元，结构性存款 147,000,000.00 元。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 5 月 31 日，首次募集资金 164,004,000.00 元已经全部投入使用。首次募集资金实际使用情况对照表详见附件 1 “首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

2、非公开发行股票、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

根据本公司《非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金项目，本公司计划将非公开发行股票募集资金分别用于翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目、电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目、江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板二期建设项目、FPC 前瞻性技术研发项目及补充流动资金；将公开发行可转换公司债券募集资金分别用于荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目、江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目及偿还银行贷款。截至 2021 年 5 月 31 日，非公开发行股票、公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照情况见附件 2 “非公开发行股票、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

2021 年本公司将非公开发行股票原募投项目“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”的募集资金 7,200.00 万元变更用于新项目“江西弘信柔性电子技术有

限公司软硬结合板建设二期建设项目”。2021 年第三届董事会第二十次会议审议、2021 年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司变更募集资金部分资金用途。

2020 年度本公司对非公开发行股票募投项目中的电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目的实施地点进行变更，本次变更经 2020 年第三届董事会第九次会议和 2019 年度股东大会审议通过。

除上述变更外，截至 2021 年 5 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金和公开发行可转换公司债券募集资金的实际投资项目与披露的募集资金运用方案均一致，无实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、 首次公开发行股票募集资金情况

首次公开发行股票募集资金项目已全部投资完毕，实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

2、 非公开发行股票、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	项目总投资	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
非公开发行股票：						
翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目	28,331.45	24,792.95	24,792.95	22,464.93	-2,328.02	注释 1
电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目	21,159.40	17,971.59	10,771.59	7,415.94	-3,355.65	注释 2
江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板二期建设项目	8,568.58	不适用	7,200.00	106.11	-7,093.89	注释 3
FPC 前瞻性技术研发项目	7,440.80	7,252.55	7,252.55	6,059.30	-1,193.25	注释 4
补充流动资金	21,000.00	20,500.04	20,500.04	20,524.29	24.25	注释 5
公开发行可转换公司债券：						
荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目	29,590.46	29,590.46	29,590.46	9,476.72	-20,113.74	注释 6
江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目	9,863.49	9,863.49	9,863.49	8,276.12	-1,587.37	注释 7
偿还银行贷款	16,767.93	16,767.93	16,767.93	16,796.09	28.16	注释 8
合计	126,739.01	126,739.01	126,739.01	91,119.50	-35,619.51	

注释 1:“翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目”实际投资小于承诺投资 2,328.02 万元,原因系受付款进度、产能调整,设备采购金额降低影响。

注释 2:“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”实际投资小于承诺投资 3,355.65 万元,原因系受付款进度、产能调整,设备采购金额降低影响。

注释 3:“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”的募集资金 7,200.00 万元变更用于新项目“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设二期建设项目”,“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设二期建设项目”实际投资小于承诺投资-7,093.89 万元,原因系项目处于建设期资金尚未完全投放。

注释 4:“FPC 前瞻性技术研发项目”实际投资小于承诺投资 1,193.25 万元,原因系项目处于建设期资金尚未完全投放。

注释 5:“补充流动资金”实际投资大于承诺投资 24.25 万元,原因系专户资金产生的利息。

注释 6:“荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目”实际投资小于承诺投资 20,113.73 万元,原因系项目处于建设期资金尚未完全投放。

注释 7:“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目”实际投资小于承诺投资 1,587.37 万元,原因系项目处于建设期资金尚未完全投放。

注释 8:“偿还银行贷款”实际投资大于承诺投资 28.16 万元,原因系专户资金产生的利息。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、首次公开发行股票募集资金情况

首次公开发行募集资金实际到位之前,本公司募集资金项目已利用自筹资金先行投入。截至 2017 年 4 月 30 日,本公司以自筹资金人民币 40,212.03 万元预先投入募投项目,致同会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,并于 2017 年 6 月 4 日出具了《关于厦门弘信电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》(致同专字(2017)第 350ZA0270 号)。2017 年 6 月 4 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金。

2、非公开发行股票、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

非公开发行股票募集资金实际到位之前,本公司募集资金项目已利用自筹资金先行投入。截至 2019 年 9 月 10 日,本公司以自筹资金人民币 5,894.70 万元预先投入翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目,致同会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,并于 2019 年 9 月 19 日出具了《关于厦门弘信电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》(致同专字(2019)第 350ZA0286),2019 年公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金。

公开发行可转换公司债券募集资金实际到位之前,本公司募集资金项目已利用自筹资金先行投入。截至 2020 年 11 月 5 日,本公司以自筹资金人民币 9,385.14 万

元预先投入荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程和江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2020 年 11 月 11 日出具了《关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0614 号），2020 年公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金。

（五）闲置募集资金情况说明

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至 2021 年 5 月 31 日，本公司前次募集资金全部用在投资项目上，累计投入人民币 16,400.40 万元。无临时闲置募集资金情况。

2、非公开发行股票、公开发行可转换公司债券募集资金情况

截至 2021 年 5 月 31 日，本公司前次募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	1,292,368,989.24
减：承销保荐费用	21,902,800.30
减：其他发行费用	3,076,044.59
募集资金净额	1,267,390,144.35
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	151,025,068.95
减：累计投入金额	760,120,466.09
减：累计银行工本费及手续费支出	49,543.01
加：银行理财收益及存款利息收入	17,821,449.47
募集资金余额	374,016,515.77
减：闲置募集资金用于购买银行理财未到期余额	228,397,115.12
募集资金专户余额	145,619,400.65

尚未使用的募集资金占前次募集资金净额的比例为 29.51%，系因募集资金项目尚在建设中，后续将根据项目实施进度陆续投入。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附件 3

非公开发行股票、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附件 4

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司的前次募集资金实际使用情况与公司在定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

附件：

- 1、 首次公开发行募集资金使用情况对照表
- 2、 非公开发行股票、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
- 3、 首次公开发行募集资金项目实现效益情况对照表
- 4、 非公开发行股票、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日

附件 1:

首次公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 5 月 31 日

编制单位: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 16,400.40			已累计使用募集资金总额: 16,400.40							
变更用途的募集资金总额: 0.00			各年度使用募集资金总额:							
变更用途的募集资金总额比例: 0.00			2018 年: 0.00							
			2019 年: 0.00							
			2020 年: 0.00							
			2021 年 1-5 月: 0.00							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 54.72 万平方米挠性印制电路板建设项目	年产 54.72 万平方米挠性印制电路板建设项目	16,400.40	16,400.40	16,400.40	16,400.40	16,400.40	16,400.40	0.00	项目共建设两条产线, 2014 年末第一条产线达到预定可使用状态, 截至 2017 年末两条产线均达到预定可使用状态。

附件 2:

非公开发行股票、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止 2021 年 5 月 31 日

编制单位: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 126,739.01			已累计使用募集资金总额: 91,119.50							
变更用途的募集资金总额: 7,200.00			各年度使用募集资金总额:							
变更用途的募集资金总额比例: 5.68%			2018 年:							
			2019 年: 33,150.67							
			2020 年: 30,060.00							
			2021 年 1-5 月: 27,908.83							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目	翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目	24,792.95	24,792.95	22,464.93	24,792.95	24,792.95	22,464.93	-2,328.02	2020 年 7 月
2	电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目	电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目	17,971.59	10,771.59	7,415.94	17,971.59	10,771.59	7,415.94	-3,355.65	2020 年 12 月
		江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板二期建设项目	0.00	7,200.00	106.11	0.00	7,200.00	106.11	-7,093.89	2022 年 8 月
3	FPC 前瞻性技术研发项目	FPC 前瞻性技术研发项目	7,252.55	7,252.55	6,059.30	7,252.55	7,252.55	6,059.30	-1,193.25	2021 年 6 月
4	补充流动资金	补充流动资金	20,500.04	20,500.04	20,524.29	20,500.04	20,500.04	20,524.29	24.25	不适用
5	荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目	荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目	29,590.46	29,590.46	9,476.72	29,590.46	29,590.46	9,476.72	-20,113.74	2021 年 11 月
6	江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目	江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目	9,863.49	9,863.49	8,276.12	9,863.49	9,863.49	8,276.12	-1,587.37	2021 年 12 月【注 1】
7	偿还银行贷款项目	偿还银行贷款项目	16,767.93	16,767.93	16,796.09	16,767.93	16,767.93	16,796.09	28.16	不适用
小计			126,739.01	126,739.01	91,119.50	126,739.01	126,739.01	91,119.50	-35,619.51	

注 1: 因为疫情影响, 生产厂房未及时交付并导致项目整体进度延迟。

附件 3:

首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止 2021 年 5 月 31 日

编制单位: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-5 月		
1	年产 54.72 万平方米挠性印制电路板建设项目	68.33%	不适用	1,697.15	5,209.74	-747.21	-166.08	5,993.60	不适用

附件 4:

非公开发行股票、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止 2021 年 5 月 31 日

编制单位: 厦门弘信电子科技集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-5 月	累计实现效益	
1	年产 54.72 万平方米挠性印制电路板建设项目	68.33%	4,289.80	不适用	301.89	-64.28	-49.60	188.01	否【注 2】
2	电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目	不适用	不适用【注 1】	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板二期建设项目	不适用	1,842.11	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	FPC 前瞻性技术研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目	不适用	7,632.71	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目	不适用	2,085.25	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
8	偿还银行贷款项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: SMT 为 FPC 生产过程中的一道工序, 并不直接产生收入, 因此承诺效益不适用。本项目效益主要体现在降低生产成本、提升公司对客户“一站式”服务能力和保证产品质量方面。

注 2: 受下游市场需求放缓影响, 产能释放进度减缓, 尚未完全释放。